

NUMBER 1903601

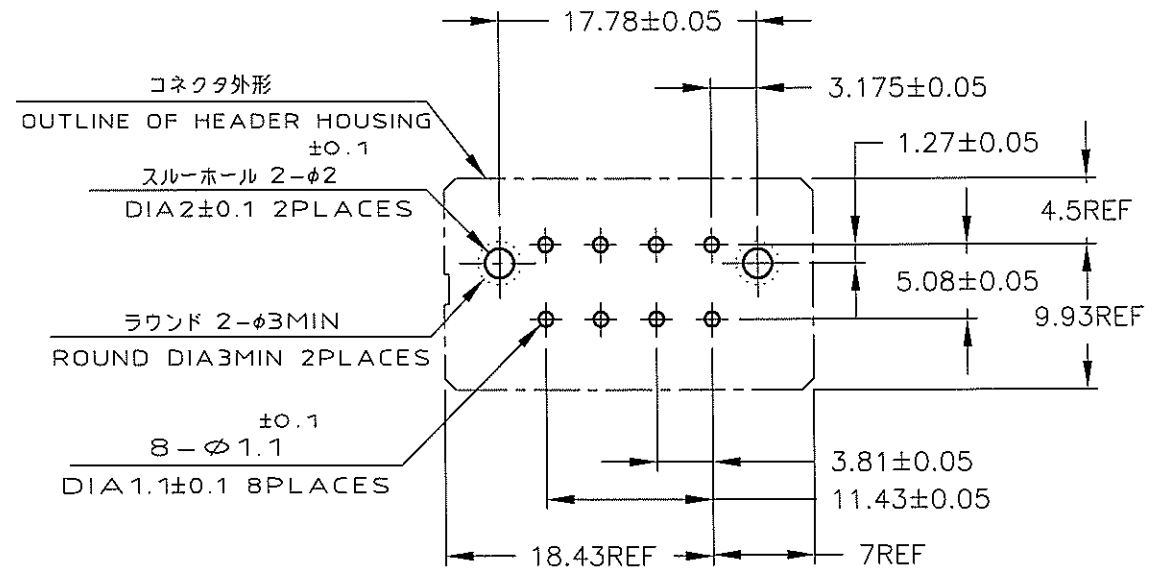
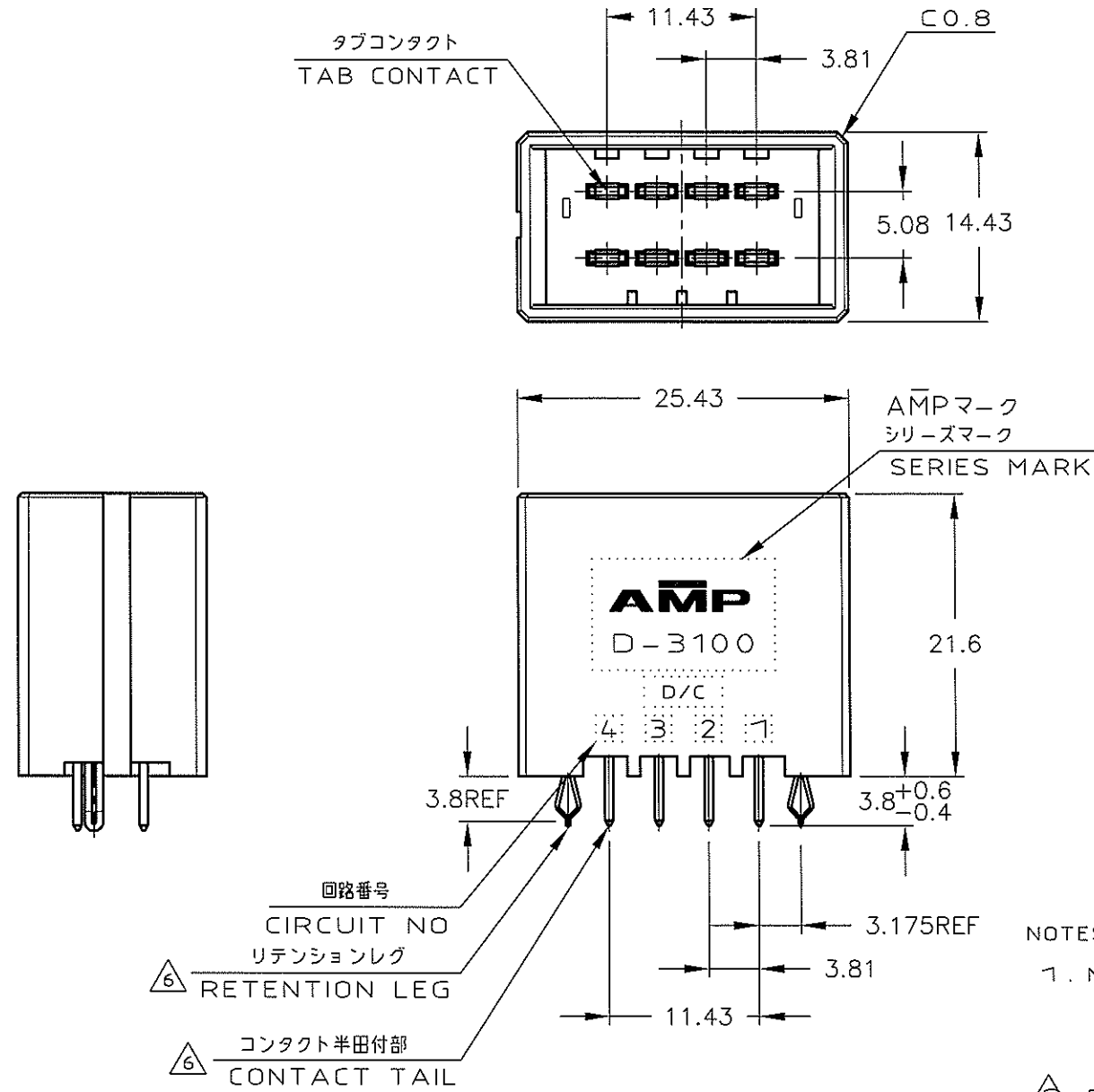


METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- ② FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- ③ FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- ④ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- ⑤ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- ② めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- ③ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- ④ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- ⑤ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

⑥	④	1903601-5
⑥	③	-
⑥	②	1903601-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

B	REVISED	ECR-06 022713	Y.Y	D.M	25SEP 2006
A	RELEASED		TS	DM	7MAR 2006
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE

Copyright © 1994 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
mm ² (AWG -)	mm ²	8 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	10mmF : ±0.3 10mmE 30mmF : ±0.4 30mmE 100mmF : ±0.45 角 度 : ±3'	A3 J C-1903601
DR.	DE.	SCALE	REV. SHEET
T.Sakamoto		2-1	B 1 of 1
CHK	APP		
D.MITSUGI	D.MITSUGI		

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)